
南亞電路板股份有限公司 2018年前三季營運概況

2018年11月23日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

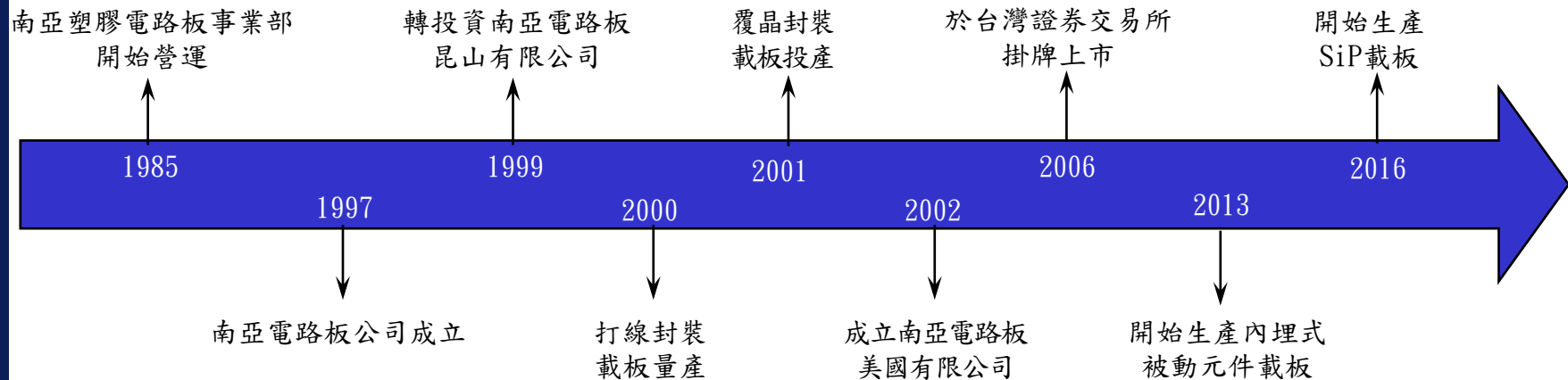
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2018年前三季合併營業額為新台幣 210.8億元。
- 台股上市市值：新台幣194.2億元(2018年9月28日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



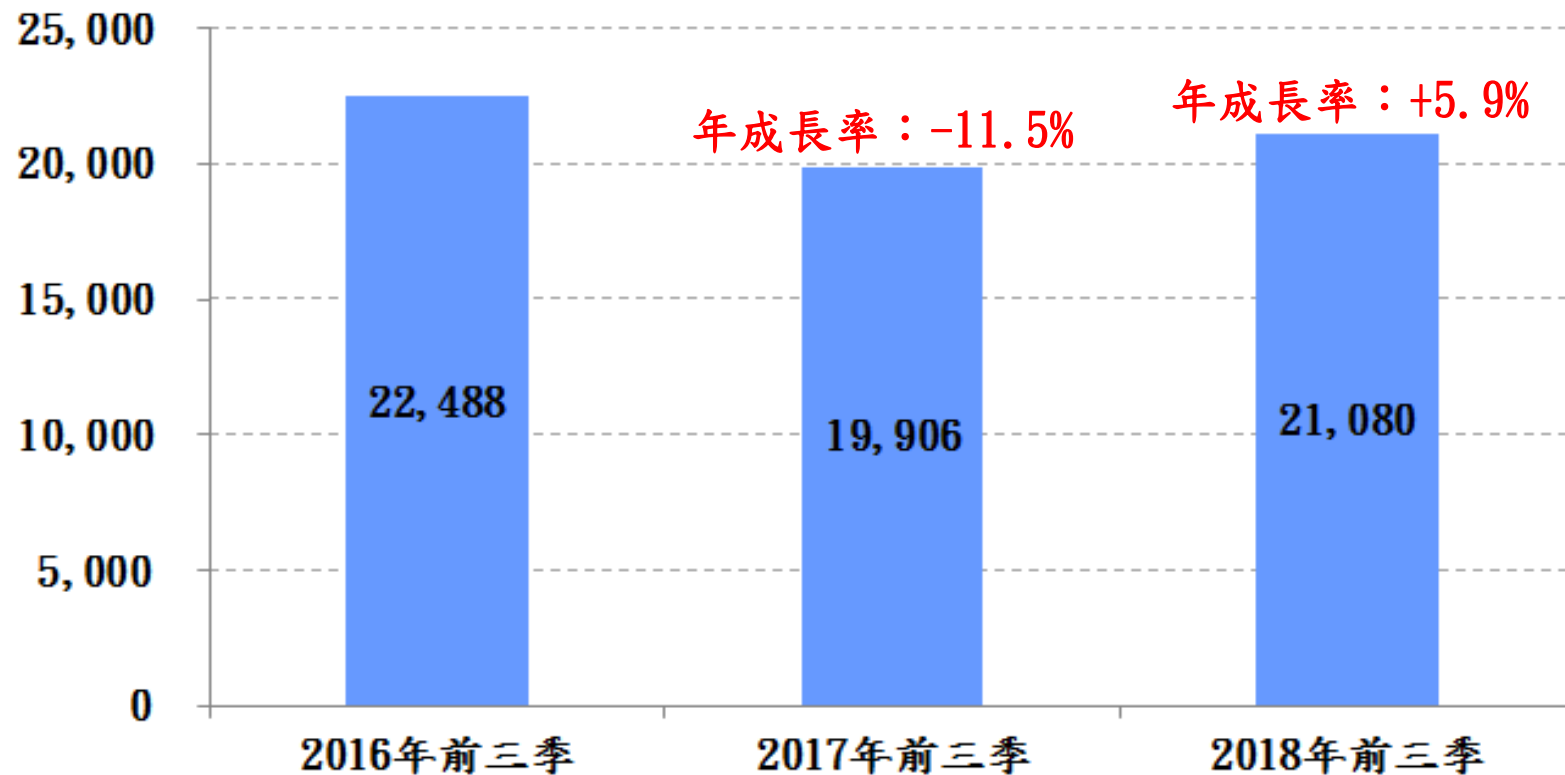
- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



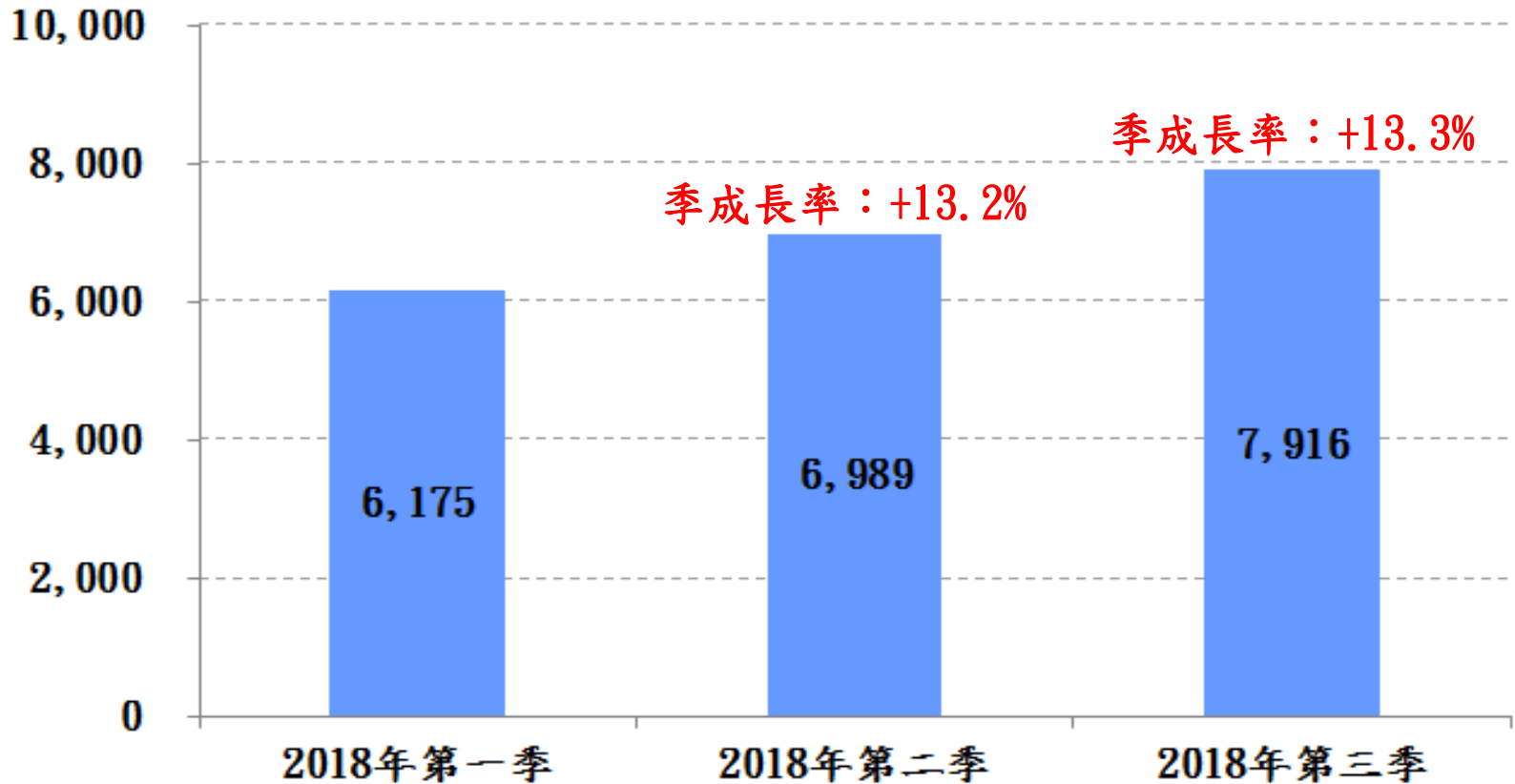
- 2017年前三季營收較2016年同期減少11.5%:
受電腦產品銷售不佳影響，本公司於2017年策略性調整產品結構，致2017年前三季比2016年同期營業額減少。
- 2018年前三季營收較2017年同期增加5.9%:
本公司致力於拓展高值化產品市場，提升產品平均售價，故2018年前三季營收比2017年同期成長。



財務狀況

近三季合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



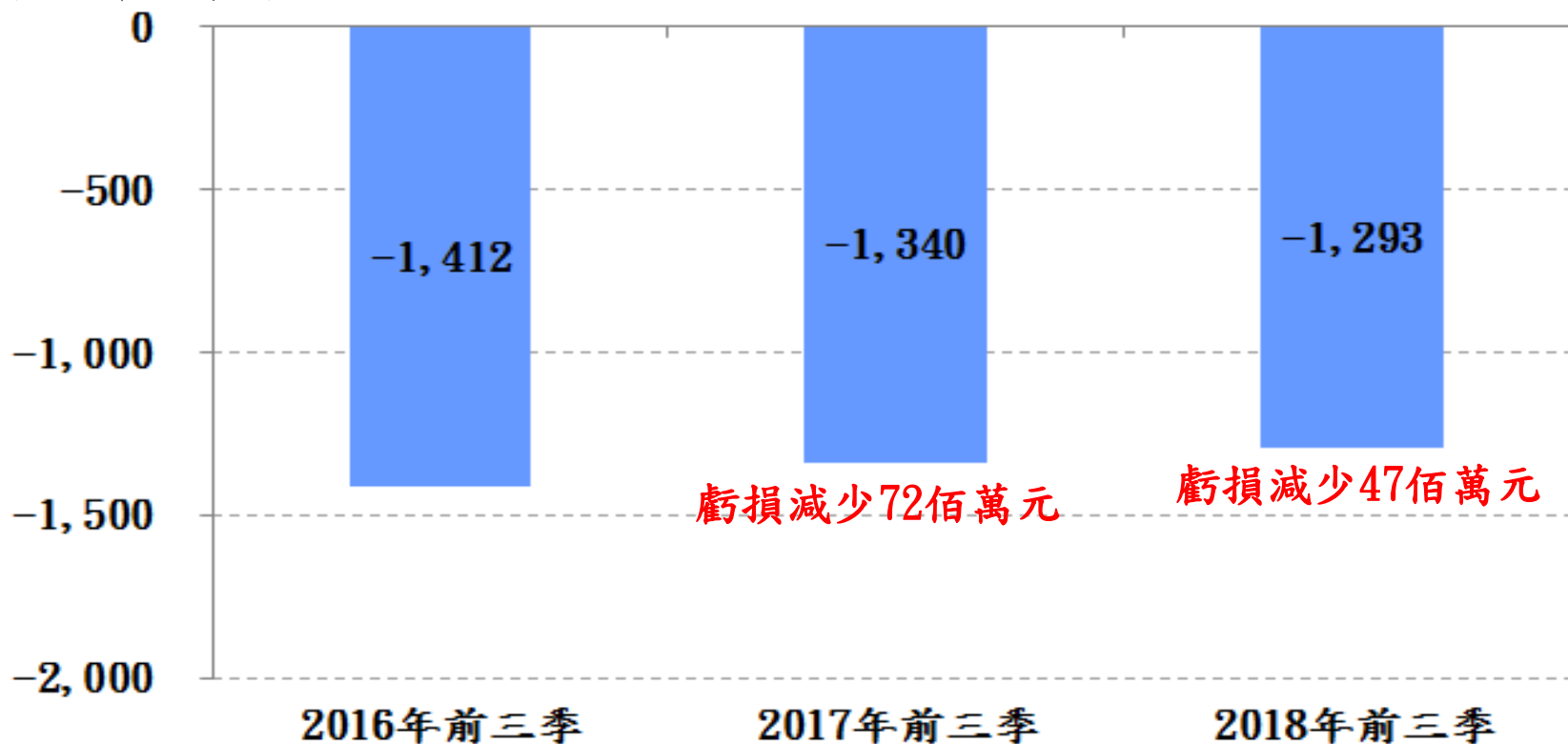
- 2018年第二季營收較第一季增加13.2%:
2018年第二季逐漸擺脫電子產品銷售淡季影響，營收比第一季成長。
- 2018年第三季營收較第二季增加13.3%:
2018年第三季因系統級封裝(SiP)與ABF載板需求提升，故第三季營收持續成長。



財務狀況

近三年營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)



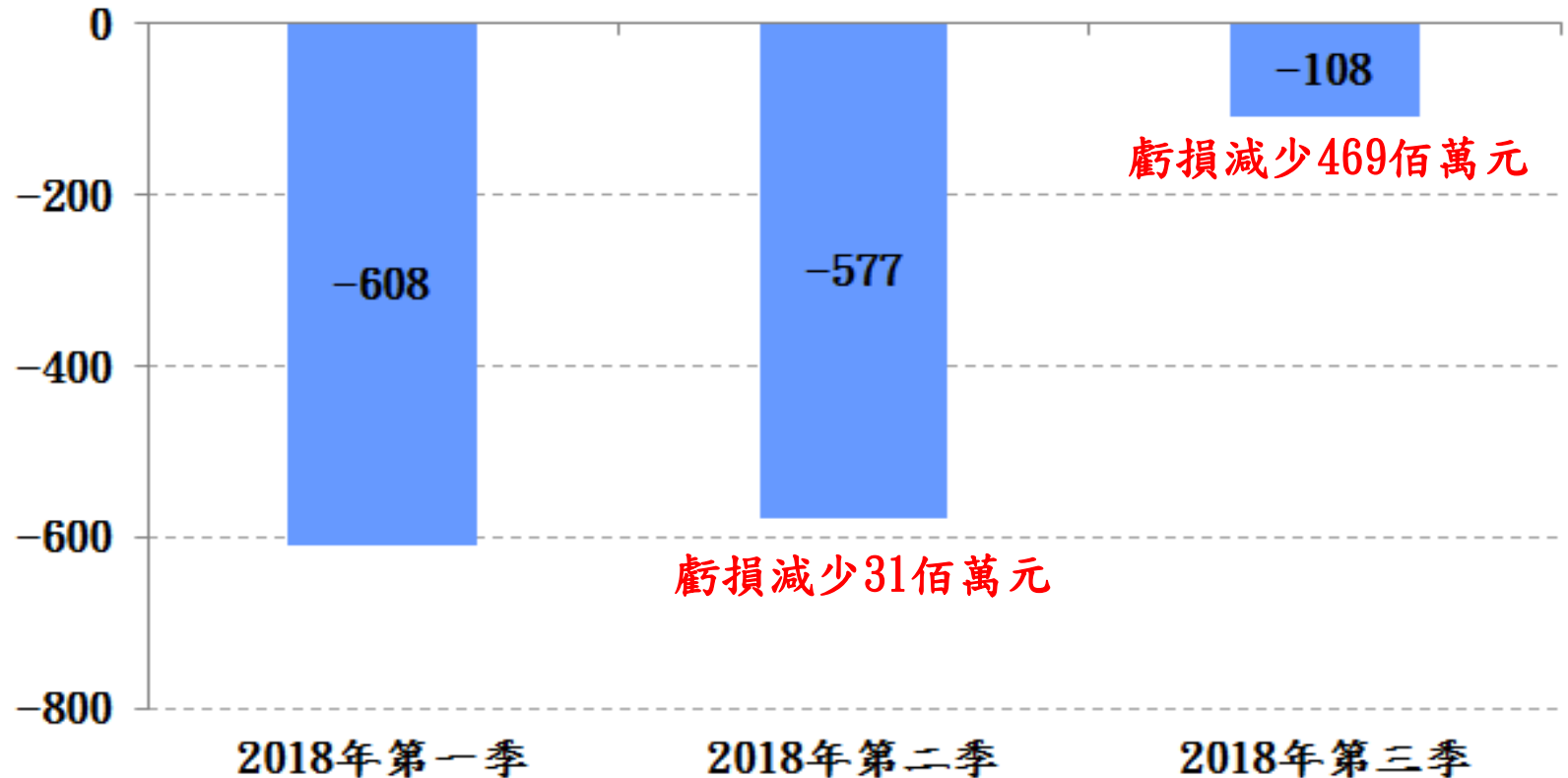
- 2017年前三季營業虧損較2016年同期減少72佰萬元：
因策略性減少虧損嚴重之個人電腦應用載板接單，故2017年前三季營業虧損比2016年同期減少。
- 2018年前三季營業虧損較2017年同期減少47佰萬元：
本公司2018年致力於提升高值化產品銷售比重，改善產品組合，使2018年前三季營業虧損比2017年同期減少。



財務狀況

近三季營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)

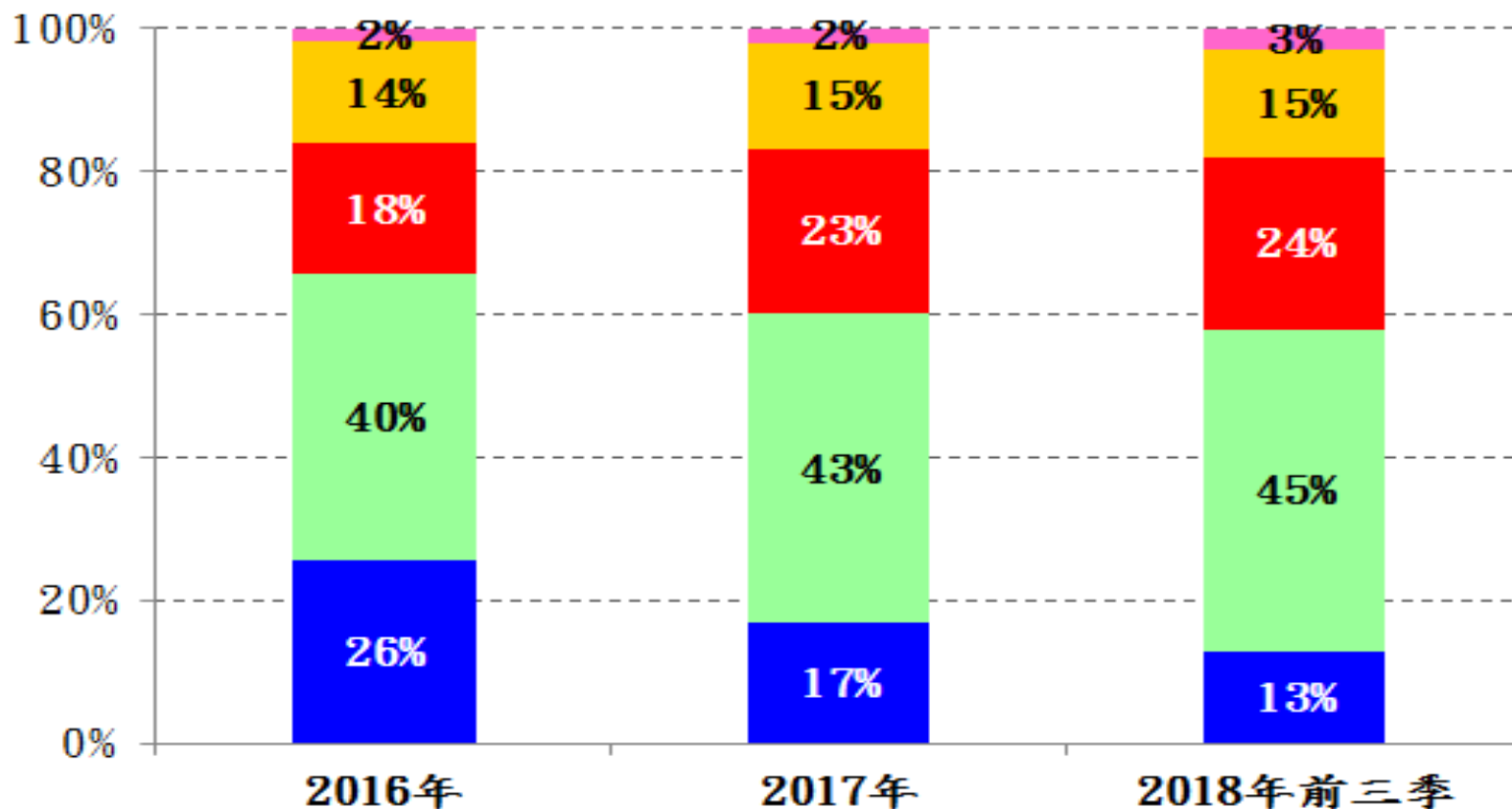


- 2018年第二季營業虧損較第一季減少31佰萬元：
因客戶需求回溫，第二季產能利用率提高，故第二季虧損比第一季減少。
- 2018年第三季營業虧損較第二季減少469佰萬元：
因高值化產品出貨量增加，且內部持續推動製程優化，提升生產效率與良率，致2018年第三季虧損比第二季大幅減少。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



■ 其他 ■ 車用電子 ■ 消費性電子 ■ 網路通訊 ■ 個人電腦

- 受個人電腦應用產品銷售不佳與調整產品結構，使個人電腦應用產品佔營收比重逐年降低。
- 配合市場趨勢，本公司積極切入網路通訊設備、穿戴式裝置(消費性電子)及高效運算(其他)領域，故此三類應用產品佔營收比重逐年增加。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 5G網通設備

2019年將陸續量產5G網通設備所需之電路板/IC載板，因其尺寸較大、層數較多、線路設計複雜、技術層次高，可有效提升產品平均售價。

■ SiP載板

伴隨高階封裝技術持續演進，行動裝置、穿戴式裝置、IoT及電子商務運用等產品將採用更多SiP載板，以符合電子產品輕、薄、短、小之發展趨勢，本公司SiP載板產品出貨量可望持續增加。

■ 車用電子

車用電子產品因涉及安全問題，故汽車與車用零組件廠商較注重產品品質，使車用電路板價格相對其他應用產品穩定；汽車在安全與環保的訴求持續提升下，對於電路板的需求隨車用電子系統的快速導入而逐年成長。

■ 人工智慧/高效運算

人工智慧與高效運算晶片因產品設計複雜，故須配合高層數與散熱佳之高階IC載板，在人工智慧與高效運算持續成長下，將帶動IC載板的需求量與價穩定增加。



未來營運目標

公司追求營業利益轉虧為盈

■ 2018年第三季營業虧損大幅減少

本公司致力於提升高值化產品出貨比重，改善產品組合，且因高層數、大尺寸載板生產良率逐漸提升，故2018年第三季營業虧損大幅減少，稅前淨利轉虧為盈。

■ 2018年第四季持續改善產品組合

本公司第三季高值化產品的穩定需求可望延續至第四季，使產品組合持續改善，並抵銷電子產業進入淡季之影響。

■ 2019年追求營業利益轉虧為盈

開源：5G商轉與人工智慧/高效運算等產品將於2019年迅速成長，除了帶動相關產品銷售外，SiP載板與車用電路板等高值化產品需求亦持續提升，有利本公司產品組合。

節流：本公司持續重整製程區加工流程及生產條件，汰換舊機，導入自動化機台等先進設備，以提升製程能力、產品良率及生產效率，2019年本公司將以營業利益轉虧為盈作為努力的目標。



感謝您的聆聽

